

【19】中華民國                      【12】發明公開公報 (A)

【11】公開編號：201921621

申請實體審查：無

【43】公開日：中華民國 108 (2019) 年 06 月 01 日

【51】Int. Cl. :                      *H01L23/498 (2006.01)*

*G02F1/13 (2006.01)*

【54】發明名稱：改善視覺外觀性及加工性的層壓石墨的膜上晶片型半導體封裝及其顯示設備

CHIP ON FILM TYPE SEMICONDUCTOR PACKAGE WITH LAMINATED GRAPHITE HAVING IMPROVED VISIBILITY AND WORKABILITY, AND DISPLAY APPARATUS THEREOF

【21】申請案號：107129170

【22】申請日：中華民國 107 (2018) 年 08 月 21 日

【30】優先權：2017/08/21

南韓

10-2017-0105442

【72】發明人：金學模 (KR) KIM, HAGMO

【71】申請人：金學模

KIM, HAGMO

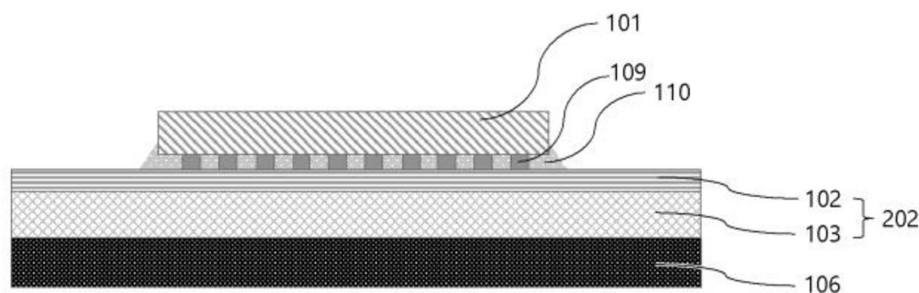
南韓

【74】代理人：楊長峯

【57】發明摘要：

本發明涉及一種膜上晶片型半導體封裝及包括其的顯示設備，所述膜上晶片型半導體封裝包括：積體電路晶片；印製電路板層；外引線鍵合墊；及石墨層，所述積體電路晶片直接或藉由貼裝元件連接到所述印製電路板層的一面上，所述外引線鍵合墊位於印製電路板層的一面上，所述石墨層層壓在所述印製電路板層的相反一面上。

指定代表圖：



第 1 圖

符號簡單說明：

101 . . . 驅動積體電路晶片

102 . . . 電路圖案層

103 . . . 基材部

106 . . . 石墨層

109 . . . 貼裝元件

110 . . . 填料

202 . . . 印製電路板層